



Představujeme Vám nový sortiment Cu-P slitin ve verzi **PLUS**.

Díky speciálnímu výrobnímu procesu zaručují Cu-P materiály ve verzi PLUS bezpečné a výkonné pájení zcela bez nežádoucího pění a rozstříku.

I když je slitina přehřátá, pájka nepění, plynule zatéká a dokonale smáčí pájené povrchy.

Výsledkem je spoj bez pórů, bezpečnější a čistší, a se zdokonalenými mechanickými vlastnostmi a zvýšenou tlakovou těsností.

Tyto pájky verze PLUS mohou být při pájení mědi použity bez přidaného tavidla a pro pájení mosazi a bronzů s vhodným typem tavidla.

Pájky verze PLUS svým chemickým složením přesně odpovídají požadavkům uvedeným v normě. Neobsahují kadmium ani olovo, čímž jsou zcela v souladu s nařízením RoHS (2011/65/EC) a jejich použití není nijak omezeno.

Jsou dostupné v následujících variantách:

CuP6 PLUS, CuP7 PLUS, CuP8 PLUS, Ag2CuP PLUS, Ag5CuP PLUS, Ag15CuP PLUS.

Technická specifikace:

OZNAČENÍ	Chem.složení %			Teplota tavení	Bod tečení	Standard
	Ag	Cu	P	°C	°C	
CuP6 PLUS	--	Bal	6,3	710-890	760	ISO 17672 CuP 179
CuP7 PLUS	--	Bal	7,3	710-820	730	CuP 180
CuP8 PLUS	--	Bal	7,8	710-770	720	CuP 182
Ag2CuP PLUS	2	Bal	6,5	645-825	740	CuP 279
Ag5CuP PLUS	5	Bal	6	645-815	710	CuP 281
Ag15CuP PLUS	15	Bal	5	645-800	700	CuP 284

Budete-li si přát bezplatný vzorek k odzkoušení, neváhejte nás kontaktovat na info@welmet.cz

Těšíme se na Vaši objednávku!